

107學年度 電子工程系 碩士班全學程開課時序表

| 第一學年(107) | | | | | |
|-----------|-------------|------|----|------|----|
| 科目 | | 第一學期 | | 第二學期 | |
| | | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 |
| 必修 | ※專題討論(一)(二) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 科技英文寫作 | 1 | 2 | | |
| | 科技英文語練 | | | 1 | 2 |
| 小計 | | 2 | 4 | 2 | 4 |

| 第二學年(108) | | | | | |
|-----------|-----------|------|----|------|----|
| 科目 | | 第一學期 | | 第二學期 | |
| | | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 |
| 必修 | ※論文(一)(二) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 小計 | | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 第一學期 | | | |
|----------|----------------|----|----|
| 科目 | | 學分 | 時數 |
| 選修 | AI機器學習語言 | 3 | 3 |
| | 數位積體電路佈局設計 | 3 | 3 |
| | 半導體製程整合技術 | 3 | 3 |
| | 積體電路量測技術 | 3 | 3 |
| | 半導體元件物理 | 3 | 3 |
| | 功率積體電路 | 3 | 3 |
| | 半導體功率元件 | 3 | 3 |
| | 系統晶片導論 | 3 | 3 |
| | 記憶體電路佈局設計 | 3 | 3 |
| | 電磁理論 | 3 | 3 |
| | 射頻電路設計 | 3 | 3 |
| | 微波工程 | 3 | 3 |
| | 微帶天線設計 | 3 | 3 |
| | 數位通訊理論 | 3 | 3 |
| | Zigbee無線感測網路系統 | 3 | 3 |
| | 平面顯示器原理 | 3 | 3 |
| | TCL/TK自動佈局設計 | 3 | 3 |
| | AI封裝檢測實務 | 3 | 3 |
| 電商網站設計 | 3 | 3 | |
| 3D遊戲設計 | 3 | 3 | |
| 太陽能發電技術 | 3 | 3 | |
| 人工智慧觸控技術 | 3 | 3 | |
| 小計 | | 66 | 66 |

| 第二學期 | | | |
|-----------|----------------|----|----|
| 科目 | | 學分 | 時數 |
| 選修 | ESD佈局設計 | 3 | 3 |
| | 類比積體電路佈局設計 | 3 | 3 |
| | 半導體封裝技術 | 3 | 3 |
| | 元件量測與可靠度分析 | 3 | 3 |
| | 相鎖迴路積體電路佈局設計 | 3 | 3 |
| | 混合積體電路佈局設計 | 3 | 3 |
| | 半導體設備機台設計 | 3 | 3 |
| | 系統晶片設計實務 | 3 | 3 |
| | 機器視覺實務 | 3 | 3 |
| | 行動通訊產業分析 | 3 | 3 |
| | 射頻積體電路設計 | 3 | 3 |
| | 微波電路設計 | 3 | 3 |
| | 行動天線設計與量測 | 3 | 3 |
| | 個人無線通訊系統 | 3 | 3 |
| | 數位電視機上盒開發 | 3 | 3 |
| | 平面顯示器技術 | 3 | 3 |
| | tensorflow人工智慧 | 3 | 3 |
| | 虛擬實境遊戲設計 | 3 | 3 |
| APP遊戲程式設計 | 3 | 3 | |
| Html手機程式 | 3 | 3 | |
| 智慧型照明系統設計 | 3 | 3 | |
| 新世代封裝測試技術 | 3 | 3 | |
| 小計 | | 66 | 66 |

| 項目 | 學分 | 時數 |
|-------|----|----|
| ※專業必修 | 8 | 10 |
| 一般必修 | 2 | 4 |
| 專業選修 | 24 | 24 |
| 合計 | 34 | 38 |

備註:

- 1.一年級每學期應修習6-15學分，二年級每學期應修習3-15學分
- 2.最低畢業學分：34學分;含必修及論文學分10學分;選修學分24學分。
- 3.本所允許跨所選修，惟本所專業選修學分不得低於21學分。
- 4.論文必修6學分，分兩學期排課，待口試通過後一次給予評分。
- 5.本所選修課程不分學年，僅分第一、二學期，由指導老師輔導選課。
- 6.表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。